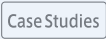
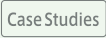
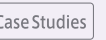
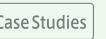
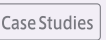
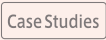


第1講演 10:20 ~ 11:05	1B1 B会場	次世代エンジニアリングに向けたAX戦略と展望 ～図研のビジョンとロードマップ2026～ 株式会社図研 執行役員 技術本部長 高木 良亮		製品の高度化や先端半導体技術の進展、サプライチェーンの変化により、製造業はかつてないスピードで変革が求められています。図研は、MBSEによるシステム設計、AIを活用した設計支援・自動化、設計プロセスをつなぐデジタルスレッドの実現を推進しています。本講演では、図研のエンジニアリングIT最新動向と今後のロードマップをご紹介します。
				
第2講演 11:20 ~ 12:00	1B2 B会場	図研ソリューションの最新動向とAIと協働する次世代設計環境のご紹介 株式会社図研 常務執行役員 事業本部長 藤原 宏行		近年の設計現場では、製品の高度化・開発期間短縮・人材不足への対応等が課題となっています。こうした課題の解決に向けて、本講演の前半は電気・電子設計および電装設計におけるソリューションの最新動向をご紹介します。後半では、AIが設計者の意思決定を支援し、開発効率化を実現する図研ソリューションの将来像をご紹介します。
				
第3講演 13:00 ~ 13:40	1A3 A会場	AI時代の次世代エレクトロニクス ～プリント配線板の要求特性と技術動向～ OKIサーキットテクノロジー株式会社 マーケティング部 部長 飯長 裕 様		AIの進展により、プリント配線板にはこれまで以上に高い性能や信頼性が求められています。AIサーバー/データセンターの今後の市場動向を見据えながら、プリント配線板に求められる伝送特性、材料(ガラスクロス、樹脂など)、技術開発の方向性について紹介します。
				
	1B3 B会場	AIの進化を支える TSMC OIP Ecosystemのご紹介 TSMCジャパン株式会社 Field Technical Support & Marketing Director 井深 洋 様		AI革命がデータセンターからエッジデバイスへと拡大する中、高性能、電力効率、およびマルチダイ設計への需要はかつてないほど高まっています。弊社最先端プロセス・パッケージング技術向け設計ソリューション、TSMC Open Innovation Platform® Ecosystemについて紹介します。
				
	1C3 C会場	なぜ今MBSEか ～最新動向と生成AIが拓く設計革新～ 株式会社図研 DX戦略室 室長 阿部 稔		製造業ではプロダクト中心からソリューション提供へのシフトが進み、開発対象は益々複雑化しています。本講演では、改めてMBSEの必要性和有効性を整理するとともに、実践事例やSysML v2などの最新動向をご紹介します。また、MBSEソリューション「GENESYS」と生成AIの活用による設計革新に向けた今後の展望をご紹介します。
		  		
	1D3 D会場	高速スイッチングデバイスを用いた パッケージ設計・最適化事例のご紹介 アルティメイトテクノロジーズ株式会社 要素技術開発部 電磁界応用設計チーム 伊藤 琢也 様		GaNやSiC等の次世代パワー半導体は電力変換回路の高効率化に有効なデバイスである一方でリンギングや発振などを考慮した設計・検証が重要となります。本講演では、UTIがDevise Tech Inc.と連携して実施しているPOL (Power Overlay) 試作基板の設計・検証プロセスについて紹介します。
				
第4講演 14:00 ~ 14:40	1A4 A会場	DS-E3によるE³.seriesと3DEXPERIENCE連携事例 株式会社FUJII ロボットソリューション事業本部 技術企画部 執行役員 部長 岡田 健人 様 技術管理課 木村 元則 様	 	E ³ .seriesとPLMの連携は長年の課題でした。今回、PLMを3DEXPERIENCEへ移行するにあたり、DS-E3を導入することで両システムの連携を実現し、設計情報管理の効率化と業務改善を達成しました。本講演では、その導入経緯と効果について紹介します。
				

第4講演 14:00 ~ 14:40	1B4 B会場	Circuit DR Navi 運用後に見えてきた 課題と改善の取り組み 株式会社エビデント 電気開発 ディレクター 益山 英之 様 電気開発 電気開発5 エキスパート 神谷 典子 様	 	Circuit DR Naviは導入して終わりではなく、作成したルールを陳腐化させないための維持管理や継続的な改善が重要です。2012年の運用開始以降、徐々に見えてきた課題への取り組みや、これまでに3回実施したブラッシュアップ活動について、本講演では実際の運用経験をもとに紹介します。
				
	1C4 C会場	Schaefflerのエンジニアリング領域における デジタル・トランスフォーメーション Schaeffler AG Engineering Digitalization & IT VP Hardware & Lifecycle Engineering Applications Mr. Christopher Höfele		Schaeffler(シェフラー)は、ヒューマノイドロボットや宇宙ビジネスといった新たな成長分野を軸にモーションテクノロジー分野をリードする企業へと変革を進めています。本講演はこの変革がエンジニアリングに与える影響の概要を、そこに図研のCR、DS-CR、GENESYSをどう活用しているかを含めて解説します。
		  		
	1D4 D会場	マテリアルズインフォマティクスの 半導体分野への適用と三次元集積回路への展開 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 半導体材料研究共創ハブ ハブ長・理事長特別補佐 公益財団法人 福岡県産業 科学技術振興財団 福岡超集積半導体ソリューションセンター センター長 知京 豊裕 様		マテリアルズインフォマティクスの半導体分野における最新動向と三次元集積回路への展開を解説します。最新AIエージェントとの連携がもたらす後工程材料開発の劇的な加速・効率化に焦点を当て、高密度実装に伴う課題解決に向けたマテリアルズインフォマティクスの事例と、先端パッケージングの未来像を考えます。
				
第5講演 15:00 ~ 15:40	1B5 B会場	エレキ業務DX化の次なる一歩 ～MBSE導入検討から見えた 課題と施策～ 東京エレクトロン宮城株式会社 技術革新室 室長 角野 英樹 様 技術革新室 野中 直哉 様	 	エレキCADや設計データ管理基盤の整備を進める中で、設計の要求・機能・設計情報の整合性確保が新たな課題として見えてきました。当社ではMBSE導入に向けてGENESYSの適用検討を実施していますが、ツール導入だけでなくその展開についても課題が明らかになっています。本講演では、導入検討で得られた知見と課題を紹介するとともに、今後のデジタルエンジニアリング実現に向けた施策と展望についてお話しします。
		  		
	1C5 C会場	E3.seriesを活用した LOVOL Heavy Industryの電気設計DX LOVOL Heavy Industry Group Co., Ltd. Electrical Engineering Department Director Mr. Bing Li		山東重工グループの中核企業であり、中国を代表する建設機械メーカーであるLOVOL Heavy Industry Group Co., Ltd.は、電気設計およびワイヤハーネス設計の標準プラットフォームとしてE ³ .seriesを採用しました。デジタルトランスフォーメーションの取り組みと、E ³ .seriesがインテリジェント建設機械の開発における設計効率、精度、および部門間コラボレーションをどのように向上させているかを紹介します。
		 		
	1D5 D会場	LPDDR5・DDR5～DDR3 高速DRAM搭載基板設計開発手法・事例 RITAエレクトロニクス株式会社 取締役 CTO 田中 顕裕 様		最新世代SDRAMのLPDDR5・DDR5、および成熟世代DDR3を対象に、パターン設計・シミュレーション手法を実例を交えて紹介する。メモリコントローラにアルテラ社Agilex™5 FPGAを用いたLPDDR5・DDR5搭載基板の設計・製作・実測を中心に、DDR3のフライバイ配線・タイミング設計の要点も取り上げる。
				
第6講演 16:10 ~ 16:50	1B6 B会場	AI時代の大企業変革をどう回すか？ ～リコーが直面したAXの壁と突破のアプローチ～ 株式会社リコー DX本部 本部長 浅香 孝司 様		AI導入だけでは業務は変わらない。リコーはBPM・BPMSを基盤に、AIを前提としたAXへ挑戦している。本講演では、既存業務やレガシーシステムと向き合いながら進めた変革の実践と、大企業が持続的にAXを推進するための組織・運営の要諦を紹介する。
				

2日目

10/16 (金)

第1講演

10:20 ~ 11:05

2B1

B会場

複雑性を抑え込み、イノベーションを再現可能にするモノづくりのOSとは
～製造業DXの本質は「スケーラビリティ」にあり～

株式会社図研
専務執行役員 事業戦略担当 上野 泰生

日本語

ZUKEN VISION

MBSE



図研の考える製造業DXは、既存業務の効率化(オーディナリー・ケイパビリティ)と 変化対応・価値創造(ダイナミック・ケイパビリティ)を 同時に底上げする「OS」を構築することにあります。その要として、設計上流をどう構造化・デジタル化し、また詳細設計と連携していくのか、本講演では今までの取り組みと今後の構想についてご紹介します。

第2講演

11:20 ~ 12:00

2A2

A会場

要求分析を起点としたシステム設計の実践と定着
～価値を考える設計者を育てるための取り組み～

株式会社東海理化
エレクトロニクスビジネスセンター
HMIエレクトロニクス技術部 第2設計室 4グループ
主幹 宮田 郁子 様
前田 健汰 様

日本語

MBSE

Case Studies



顧客価値につながる開発・提案ができる設計者の育成を目指し、要求分析を起点としたシステム設計の実践活動を展開している。ガイドライン整備や教育構築を通じた設計力向上と、組織への定着に向けた取り組みを紹介する。

Timetable

1日目		10/15 (木)		受付開始 9:50~		2日目		10/16 (金)		受付開始 9:50~	
プログラム	TIME	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	プログラム	TIME	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場
第1 講演	10:20 ~11:05	 B会場中継	1B1  J▶E			第1 講演	10:20 ~11:05	 B会場中継	2B1  J▶E		
第2 講演	11:20 ~12:00	 B会場中継	1B2  J▶E			第2 講演	11:20 ~12:00	2A2  J▶E	2B2	2C2	2D2
第3 講演	13:00 ~13:40	1A3	1B3	1C3  J▶E	1D3	第3 講演	13:00 ~13:40		2B3  J▶E	2C3	2D3
第4 講演	14:00 ~14:40	1A4	1B4	1C4  E▶J	1D4	第4 講演	14:10 ~15:10	2A4			
第5 講演	15:00 ~15:40	 B会場中継	1B5  J▶E	1C5  C▶J	1D5	50周年記念PARTY 創立50周年を記念した、皆さまへの感謝を込めたパーティーです。 この日限りの演出をご用意して皆さまをお迎えいたします。 アニバーサリーの特別なひとときを、ぜひ一緒に過ごしてください。					
第6 講演	16:10 ~16:50	 B会場中継	1B6								
	16:50~			懇親PARTY							
懇親PARTY お客様、ご講演者様、図研社員も交えての情報交換会です。お気軽にご参加ください。											

【アイコンの説明】

日本語

「英語」での講演を「日本語」に同時通訳

中国語

「中国語」での講演を「日本語」に同時通訳

日本語

「日本語」での講演を「英語」に同時通訳

MBSE

「MBSE」に関する講演

第2講演

11:20 ~ 12:00

2B2

B会場

Board DesignerからDesign Forceへの移行と展望

セイコーエプソン株式会社
システム企画部 シニアスタッフ 長岡 敬 様

Case Studies



既存の基板設計環境の刷新に伴い、新たな設計環境への移行を推進しています。本講演ではユーザー企業の立場から、選定で重視したポイントや決め手、移行計画の規模感、基板設計CAD環境を短期間で円滑に構築できた背景を紹介しす。さらに、今後の設計環境の展望や図研への期待についてお話しします。

第2講演

11:20 ~ 12:00

2C2

C会場

BOM×AIが実現する次世代モノづくり
～データがつなく設計・製造連携～

株式会社図研ブリサイト
代表取締役社長 小田 泰久

TREND



長らく設計・製造データをつなぐ役割を担ってきたPLMシステムはAIの発展を一因として、モノづくりにおけるその役割が変化し始めています。本講演ではVisual BOMによるエレキ、メカ、ソフトの情報一元化に加え、蓄積された知見やデータを意思決定へ活かし判断の高度化を実現する新たなPLMの姿をご提案します。

第2講演

11:20 ~ 12:00

2D2

D会場

AI・量子時代のコンピューティング革命と日本の役割

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター
センター長 益 一哉 様

ACADEMIC



AIと量子コンピュータの進展は、コンピューティングそのものを大きく変えようとしている。重要なのは計算能力そのものを競うことではない。世界の産業エコシステムの中で、日本が不可欠な存在となる役割を築くことである。本講演では、量子・古典融合計算とG-QuATが目指す産業戦略について紹介する。

第3講演

13:00 ~ 13:40

2B3

B会場

MBSEで組織資産化へ
～GENESYSによる設計意図と規格知識の継承～

古野電気株式会社
取締役上席執行役員 兼 CTO 徳田 浩二 様
技術統括部 開発基盤管理課 課長 小山 幸次 様

日本語

MBSE

Case Studies



古野電気では、GENESYSを活用したMBSEにより、設計意図や規格知識の組織資産化を推進しています。本講演では、実開発での適用事例を交え、意思決定の根拠を継承する仕組みとその効果、さらにAI活用を支える情報基盤構築の展望について紹介します。

第3講演

13:00 ~ 13:40

2C3

C会場

技術をつなぎ、強みを活かす！
設計DXに向けたECM構築

株式会社チノー
経営管理本部 DX戦略統括部
DX戦略統括部長 執行役員 山下 卓 様

Case Studies



設立以来90年、誠実に計測技術と向き合ってきたチノー。歴史の中で培ってきた技術を次へつなぐ一方、属人化防止・技術継承、生産性向上、法規制やセキュリティ対応など、設計開発を取り巻く環境は変化しています。そこで「人」を磨き「自社の強みを力に」変革する挑戦として「設計DX」を推進。図研とともに、さらなる進化に挑んでいます。

第3講演

13:00 ~ 13:40

2D3

D会場

続・基板設計ノウハウの真実
～6GHz・差動信号の放射ノイズ実測検証～

株式会社オンテック
プリント回路デザイン技術本部
執行役員技術本部長 徳 正一郎 様

Case Studies



大反響を呼んだ昨年の「EMC Adviser EX」実測検証の続編です。今回は以下の最新データを公開します。

- ・ 昨年の検証結果に対するさらなる深掘り考察
- ・ 測定周波数帯域を「6GHz」まで拡大したノイズ評価
- ・ 高速通信に必須の「差動信号」における放射ノイズ実測

皆様のノイズ対策業務にお役立ていただければと思います。

第4講演

14:10 ~ 15:10

2A4

A会場

宇宙ミッションに学ぶ、
「想定外」に耐える
人づくり、チームづくり

宇宙飛行士
野口 聡一 様

***** 50周年記念 特別講演 *****



スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴンの3種の宇宙船に搭乗し、国際宇宙ステーションでの長期滞在を経験した野口聡一氏が登壇。常に「想定外」と隣り合わせの宇宙ミッションで培った知見から、変化に強い人材育成とチームづくりを解説します。高い安全性と品質が求められる製造業において、現場力と組織力を高めるヒントが得られる講演です。